

陶瓷电容器



GMD 系列



民用设备 & 工业设备用打线/AuSn 焊接型片状多层陶瓷电容器

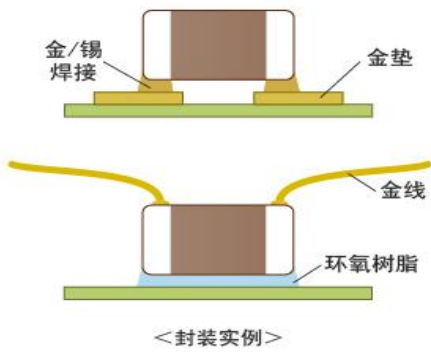
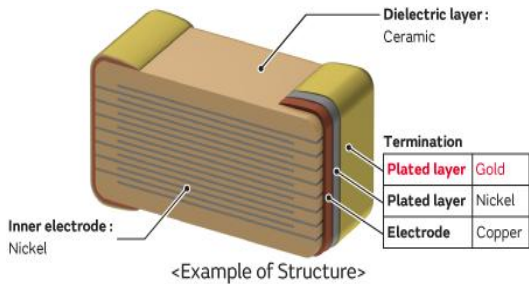
适用用途

- 民用设备
 - 汽车信息娱乐/舒适设备
 - 医疗设备[GHTF A/B]
 - 医疗设备[GHTF D]
 - 植入式医疗器械设备或医疗器械设备[GHTF D]
 - 移动设备
 - 运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备
 - 适用商品：冲击传感器
- 工业设备
 - 汽车动力总成/安全设备
 - 医疗设备[GHTF C]
 - 植入式以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]
 - 植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]
 - 民用设备-差分传输
 - 硬盘

产品特点

1. 引线接合贴装 AuSn 焊接贴装专用产品

外部电极上采用镀 Au，可进行引线接合和 AuSn 焊接贴装。



※该产品是引线接合贴装、AuSn 焊接贴装专用产品。请勿使用该贴装方法以外的方法。

2. 非常适合用于光通信相关设备、IC 等的包内封装。

TO-CAN 和 IC 等封装内，焊线封装把电容器内藏，因此减少了布线，可实现低噪化和高性能化。

3. 为套件的小型化做出贡献。

具备 0603(0201)、1005(0402)单位 mm(英寸)的小型品阵容。

规格

产品尺寸	0.6x0.3mm - 1.0x0.5mm
额定电压	6.3Vdc - 50Vdc
静电容量	100pF - 1.0μF
主要用途	1. 光通信相关设备 2. 针对 IC 内的封装

高介电常数型

[illegible]